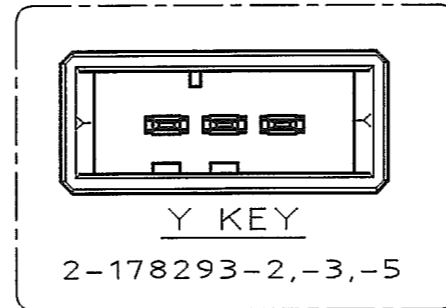
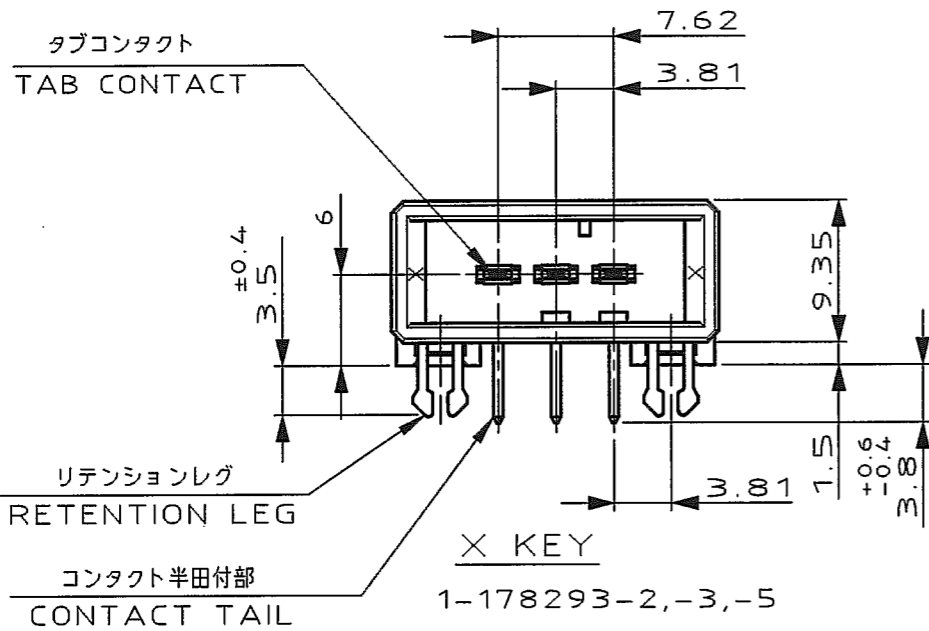
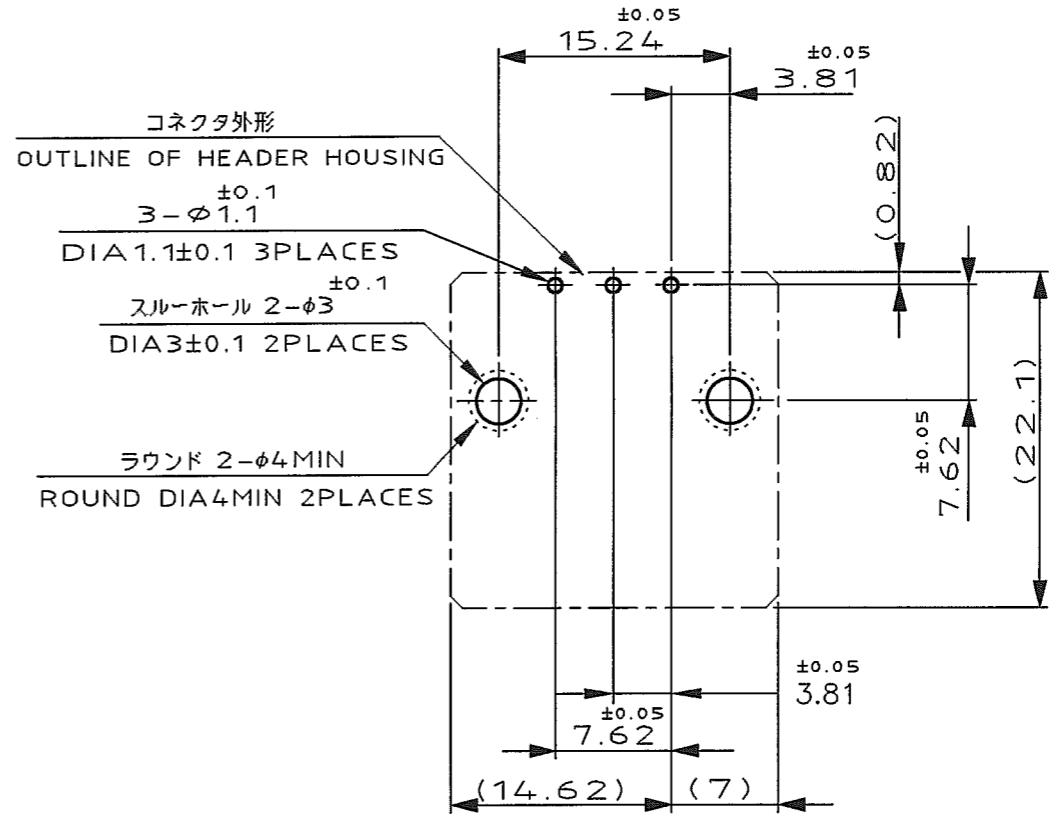
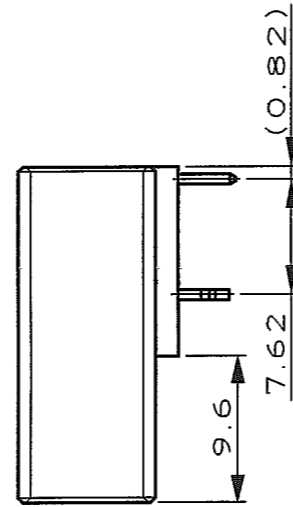
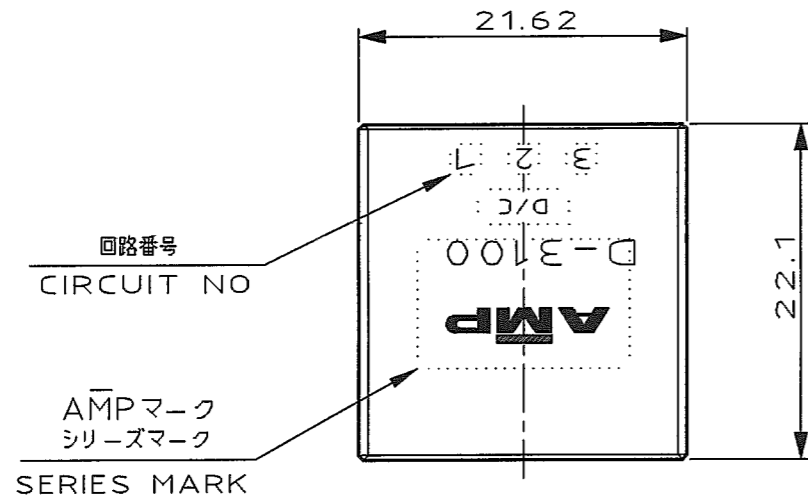


NUMBER 178293
 METRIC
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST



推奨基板取付け穴寸法
 PC 基板厚: 1.6±0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- ~~FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- ~~めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき~~
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	1,2-178293-5
△6	△3	1,2-178293-3
△6	△2	1,2-178293-2
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)	

C1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	14 APR 11	DR. K.IKEDA	20/MAR/95	DE. K.IKEDA	20/MAR/95
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	CHK. S. MANABE	23/MAR/92	APP. S. MANABE	23/MAR/92

WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm (AWG -)		mmφ		3 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
DR. K.IKEDA		DE. K.IKEDA		SIZE	LOC
CHK. S. MANABE		APP. S. MANABE		A3	J
				NUMBER	C= 178293
				SCALE	REV. C1
				2-1	SHEET 1 OF 1



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)